



「ちょうどいい」のに「高性能」。
あなたのご要望にお応えします。

半導体やLEDの封止・実装プロセスに効果を発揮
加圧オープンシリーズ

あなたの現場での、オープンに求めることを教えてください。温度管理やタイマー機能だけでは満足できないのではないのでしょうか。

「加圧オープンシリーズ」は、「真空」「加圧」「脱泡」など目的に合わせてお選びいただけます。



コンパクトな卓上型から、本格的なマルチ型まで。加圧オープンのラインナップ。

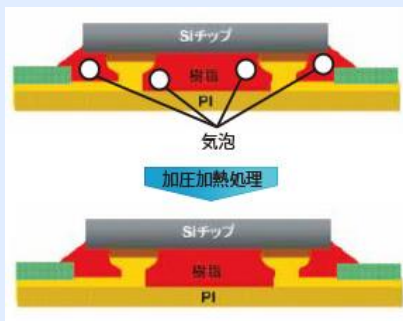
POINT 1 樹脂封止には必要不可欠

「樹脂封止」は、「樹脂成形」または「モールド成形」と呼ばれ、半導体の組立てには欠かせない工程です。「加圧オープンシリーズ」は、半導体実装の確実性を高めます。



POINT 2 加圧オープンの効果

樹脂を硬化させる時にやっかいなのが気泡です。「加圧オープンシリーズ」は、加圧雰囲気下で加熱・硬化することで気泡を消滅させ、封止効果を高めます。



POINT 3 加圧オープンのラインナップ

卓上型 加圧減圧 オープン PCO-083TA	■ 一台で「加圧」「減圧」の両方処理が可能 ■ 加圧時は加熱による圧力上昇を制御 ■ 最大温度350℃（オプション400℃）での処理が可能 ■ マニュアルタイプとオートタイプのラインナップ
自動加熱 加圧処理 装置 ACS シリーズ	■ マグネットカップリング方式による攪拌機構で、安定した温度分布 ■ 処理試料に合わせた各種サイズをラインナップ ■ N2ガス対応 ■ 最大圧力0.8MPa（オプション時1.0MPa）
加圧脱泡 装置 TBR シリーズ	■ マグネットカップリング方式による攪拌機構で安定した槽内温度分布 ■ ラボタイプの小型サイズから大型サイズまでをラインナップ ※PCO-TシリーズはN2非対応です。

お問い合わせ先

E-mail: otoiawase.atcr@ml.ntt-at.co.jp
TEL: 088-699-7511

NTT-ATクリエイティブ株式会社
徳島県板野郡松茂町中喜来字福有開拓308-6
<https://www.ntt-atcr.co.jp>

